

スタンドアロン超音波金属接合装置

UB500SA

Ultrasonic metal bonder

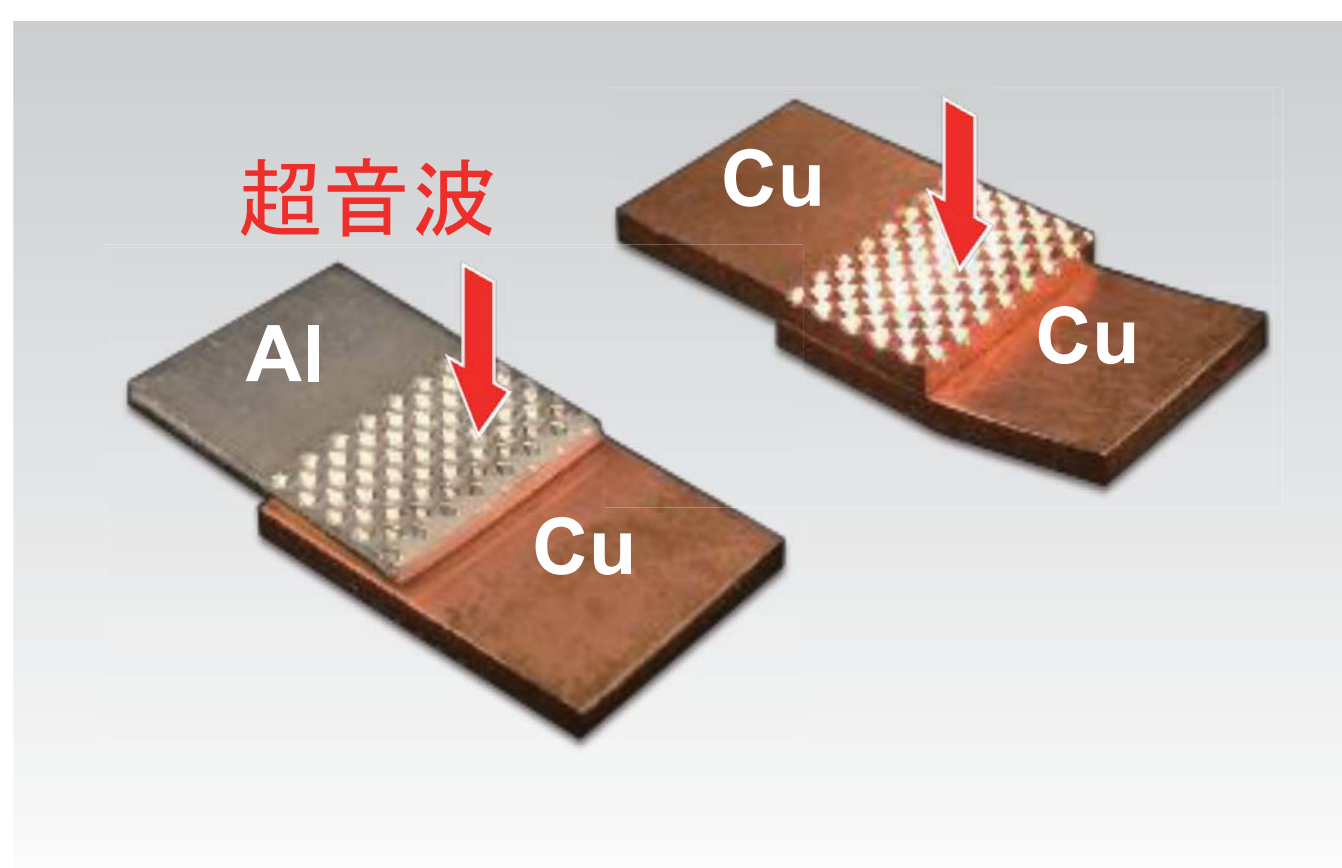
生産現場や開発現場に配置し易いコンパクトな超音波接合機



ヘッド荷重	荷重 10 ～ 500N
ヘッド種類	超音波ヘッド
超音波周波数	周波数：30kHz/40kHz(350/750W) ,50kHz(250W)
ヘッド制御	荷重、超音波のデジタル制御
接合モニタリング	プロファイル参照ソフト標準搭載
レシピー	接合条件：デジタル設定
ユーティリティ	空圧源 0.5MPa ドライエアー
	電 源 本体 100V10A 発振器 30kHz/40kHz:100V5.2A/10A ,50kHz:100V2.5A
ユニットサイズ	W400 x D860 x H606mm (本体部)
ユニット重量	150kg

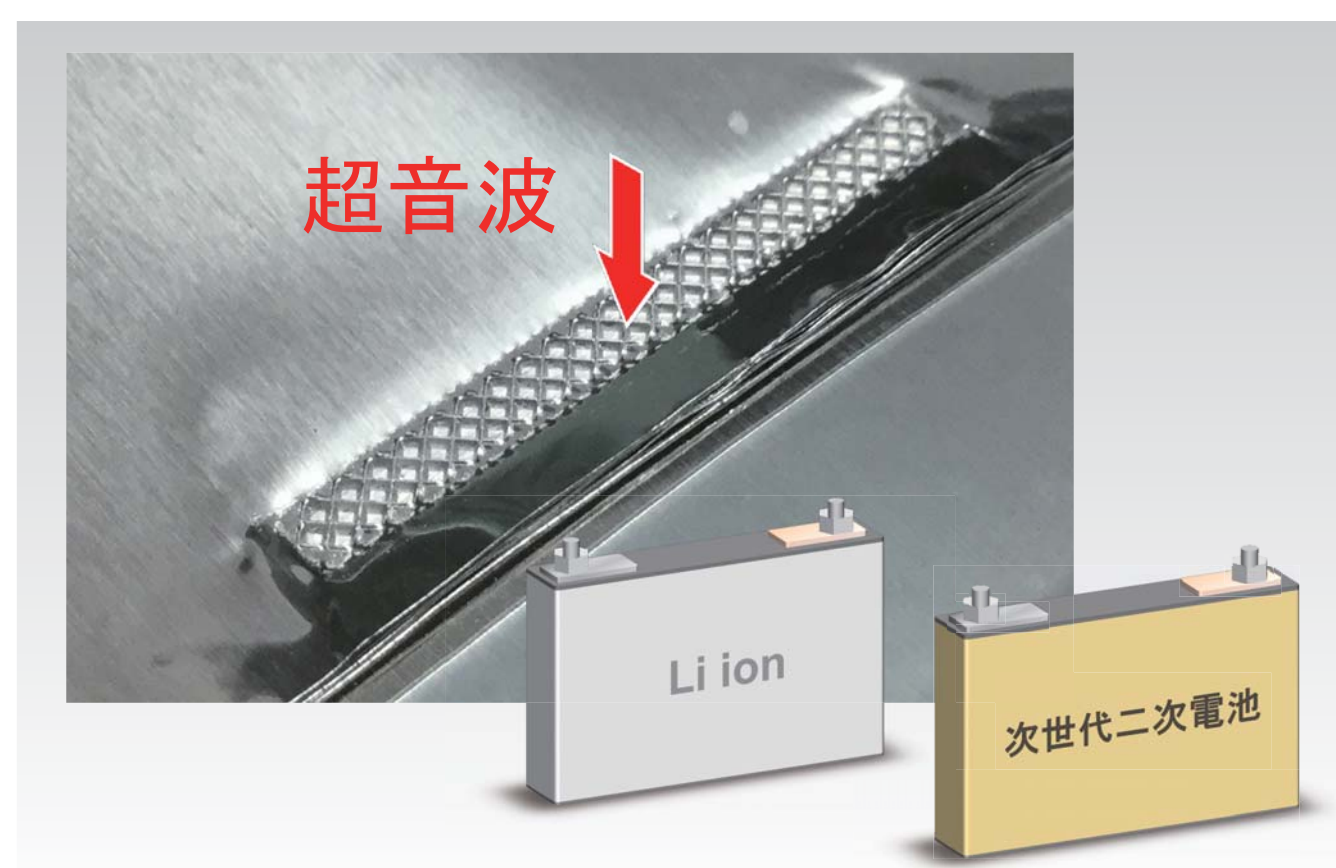
アプリケーション

●同種・異種金属接合

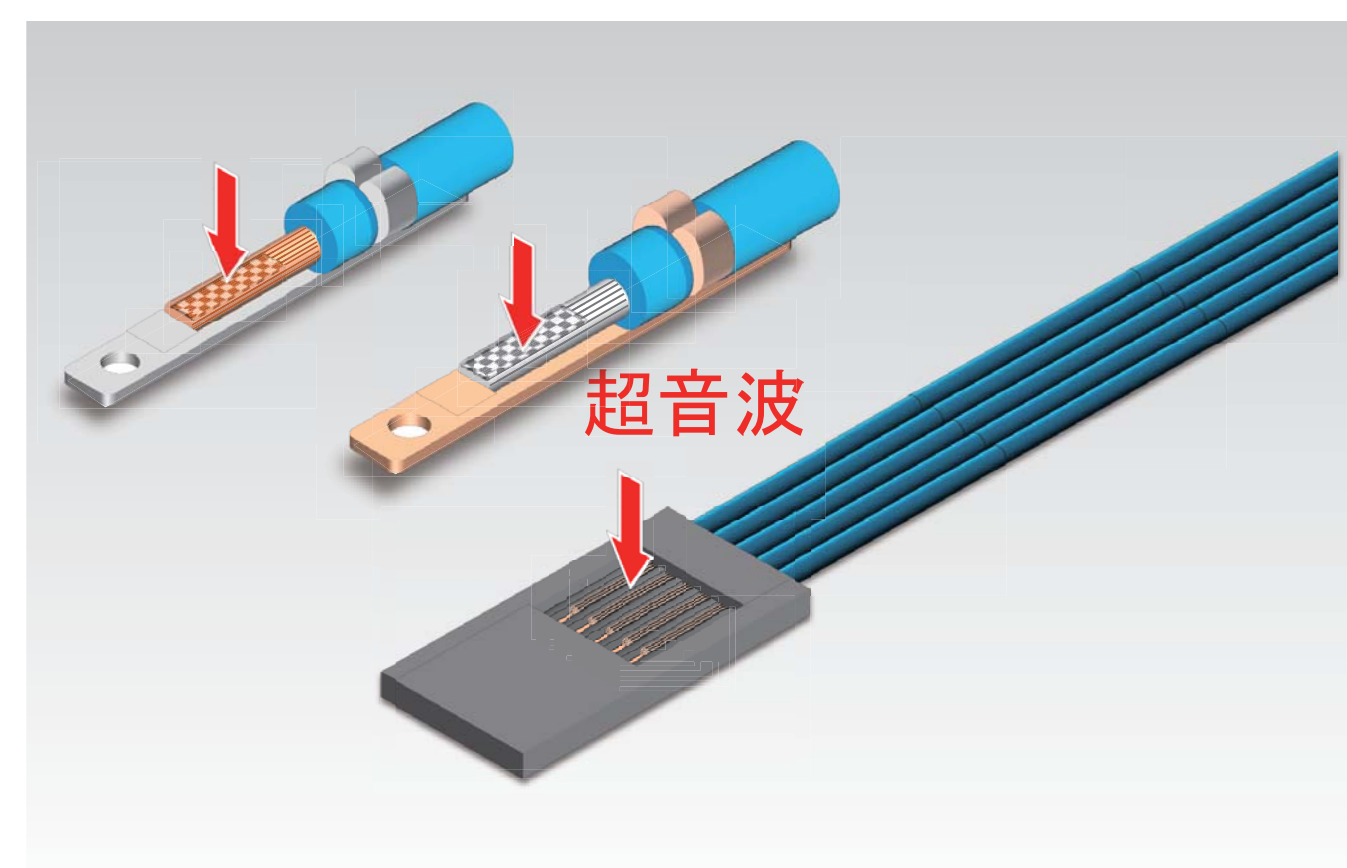


同種金属の接合に加えて、溶接では困難な異種金属の接合が可能

●二次電池金属箔一括接合

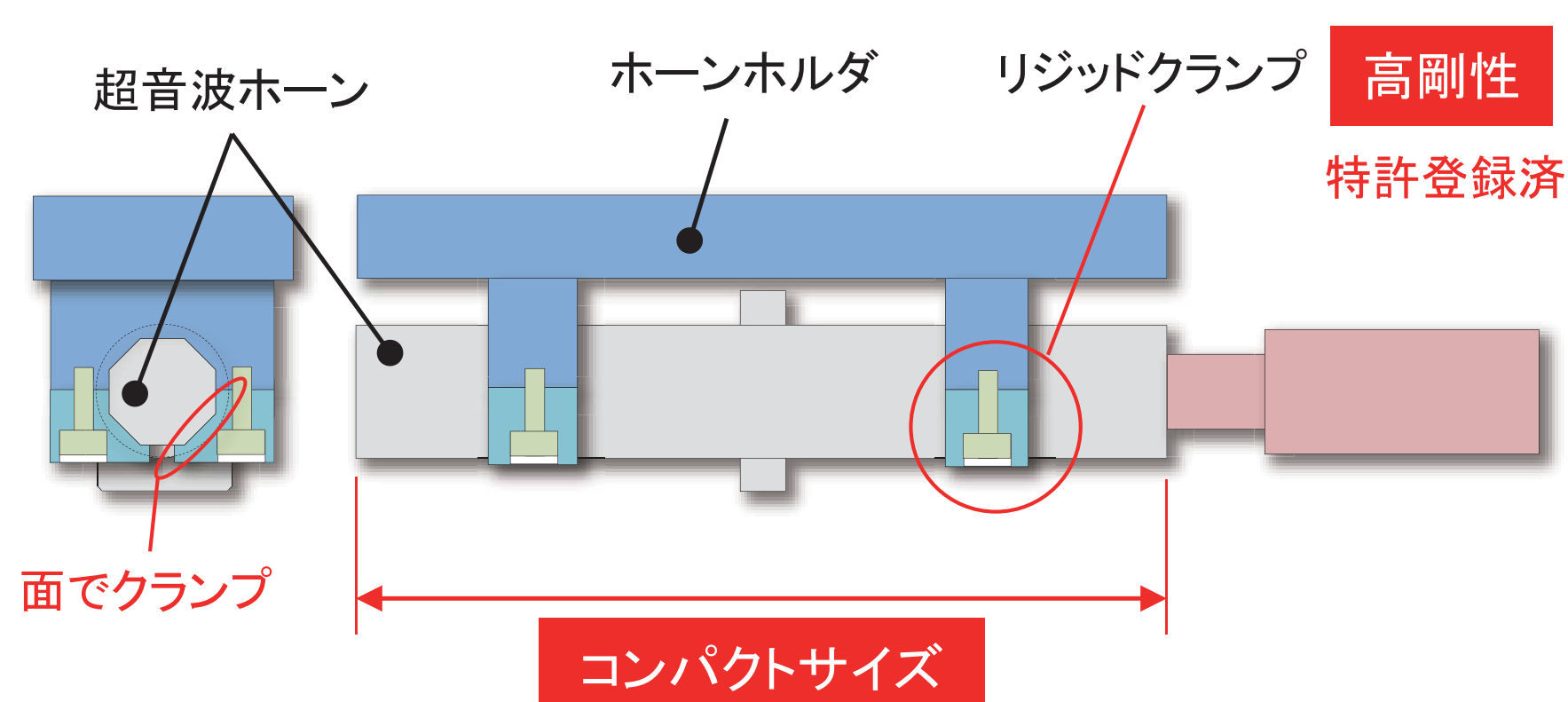


●ワイヤーハーネス・コネクタ接合



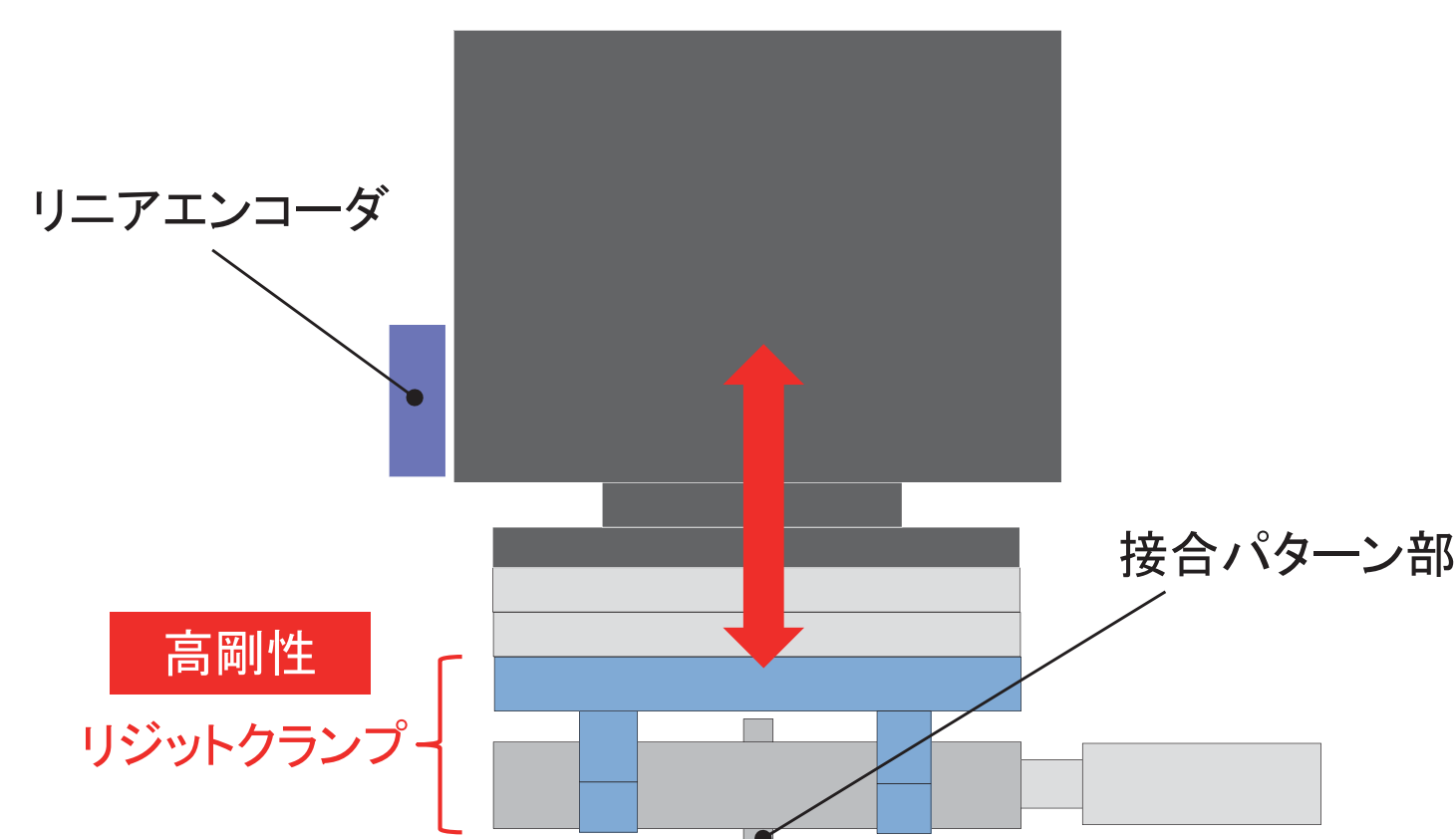
高剛性ホーンクランプ機構

【リジッドクランプ】によって、超音波ホーンをダイレクトにクランプ。これにより超音波ヘッドは高剛性かつ、コンパクト。



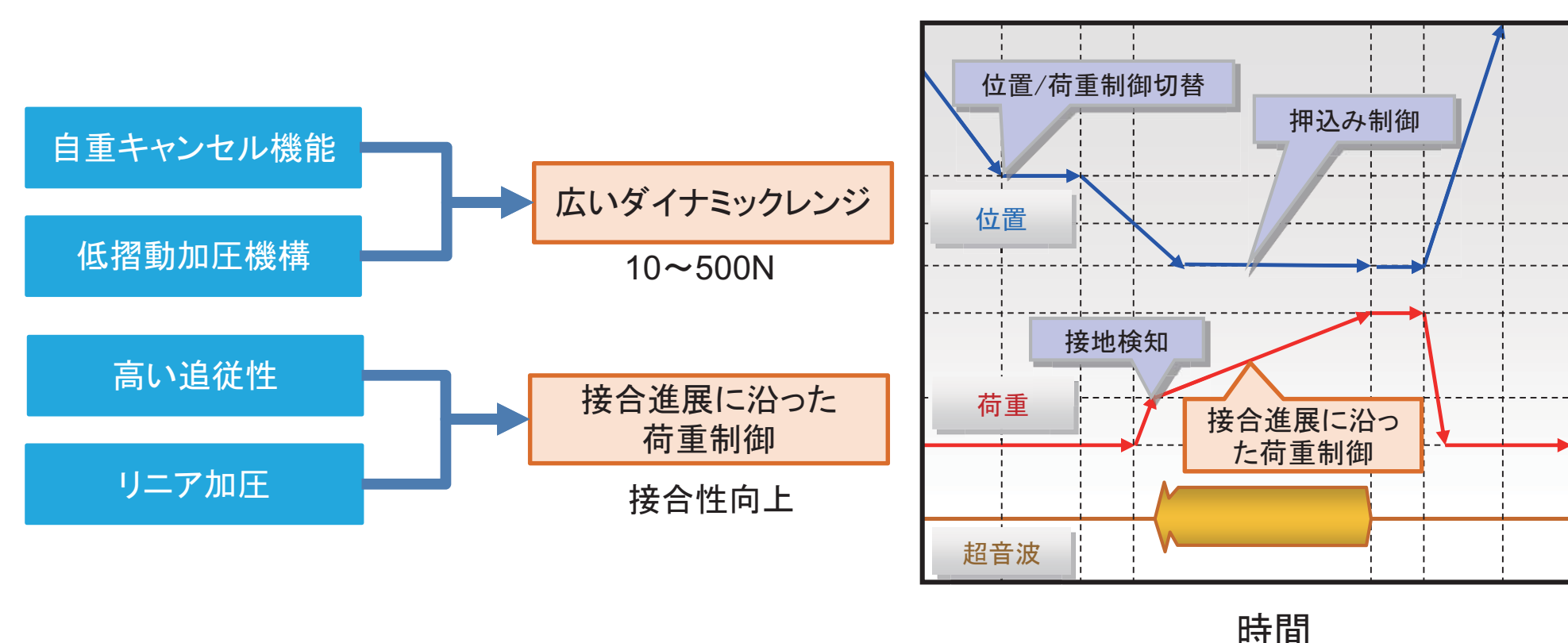
高精度位置制御

接合ヘッド内蔵のリニアエンコーダとリジッドクランプにより高剛性の超音波ホーンユニットで接合部の位置を正確に制御。



高機能荷重制御

低摺動加圧機構による広いダイナミックレンジを実現。接合時の変形に高い追従性を持ち、接合進展と共に荷重を上げるリニア加圧でにより接合性が向上。



充実したプロセスモニタリング機能

装置に内蔵された各種センサ情報により、プロセス動作を詳細に把握でき、プロセス立ち上げ、量産管理に有効。

